



Toshiba 64 Katmanlı 3D Flash Bellek İçeren Tek-Paket SSD Üretiyor

Yeni BG3 NVMe^[1] SSD'lerin ultra kompakt tasarımı, mobil bilgisayar ve Nesnelerin İnterneti aygıtlarının daha küçük, daha hafif, daha hızlı ve güç yönünden daha verimli olmasını sağlıyor

Düsseldorf, Almanya, 3 Ağustos 2017 - Toshiba Electronics Europe GmbH bugün, en gelişkin katı durum sürücü (SSD) olan BG3 serisinin üretimini başladığını duyurdu. BG3 serisi, Toshiba'nın en yeni, 64 katmanlı, hücre başına 3 bit TLC (üç düzeyli hücre) BiCS FLASH'ına dayanan, yeni kuşak tek-paket, yuvarlak ızgara dizisi (ball grid array, BGA) katı durum sürücü (SSD) ürünlerinden oluşuyor. Mobil aygıtların geleceğini şekillendirmek üzere tasarlanan Toshiba BG3 SSD'ler daha iyi performans^[2] ve geleneksel SATA temelli sürücülere kıyasla daha küçük bir ayakizi sunuyor. Dahası, DRAM içermeyen, maliyet etkinlikli tasarımıyla eşsiz BG3 serisi, diğer NVM Express^[3] (NVMe) SSD'lere^[4] kıyasla çok daha düşük güç ihtiyacıyla üstün kaliteli bir kullanıcı deneyimini mümkün kılıyor.

Toshiba'nın BG3 serisi, NVMe Revision 1.2.1'deki Ana Bilgisayar Bellek Tamponu (Host Memory Buffer, HMB) özelliğini devreye sokarak, flash yönetimi için ana bilgisayar belleğini kullanıp entegre DRAM gereği olmadan yüksek performans sağlıyor. Bu güçlü bileşim, aygıtların NVMe depolama performansından yararlanmasını ve aynı zamanda küçük bir ayakizi ve ucuzluk sağlayarak kullanıcılara bir yeni kuşak mobil deneyimi sunmasını mümkün kılıyor. Hem hızlı hem ekonomik olan bu minyatür SSD'ler ayrıca veri merkezi ve şirket uygulamaları için sunucu boot depolamanın alternatifini sunuyor.

Günümüzün laptop ve tablet imalatçıları için stil ve taşınabilirliğin taşıdığı önem göz önünde bulundurularak, BG3 serisi özellikle daha da ince ve güç yönünden daha verimli aygıtlar üretilmesini sağlamak amacıyla tasarlandı. DRAM gereğini ortadan kaldıran tasarımıyla, Toshiba'nın BG3 serisi sadece 1,3 mm yüksekliğinde dünyanın en ince SSD'lerini^[5] sunuyor ve pil ömrünü uzatmak amacıyla daha düşük güç tüketimi sağlıyor.

Toshiba BG3 SSD'ler boyut olarak küçük, ama performans açısından değil. PCI Express (PCIe)^[6] Gen3 x2 yolu ve NVMe Revision 1.2.1 mimarisi içeren BG3, 1520 MB/s'ye varan ardışık okuma (6 Gbit/s SATA'nın teorik maksimum bant genişliğinin 2,7 katı genişlik), 840 MB/s'ye varan ardışık yazma^[7] (6 Gbit/s SATA'nın teorik maksimum bant genişliğinin 1,5 katı genişlik) sunuyor. Ayrıca BG3, Windows^[8] temelli PC'lerde rutin olarak karşılaşılan türden patlama tipi iş yüklerini hızlandırmak için mükemmel performans sunan SLC önbellek içeriyor.

Ultra kompakt BG3 serisi 128GB, 256GB ve 512GB kapasitelerle^[9] mevcut. Modellerin üçü de, platform tasarımında esneklik sunmak amacıyla, yüzeye montajlı BGA (M.2 1620) veya sökülebilir modül (M.2 2230) form faktörüyle mevcut.

Toshiba Electronics Europe, SSD İş Birimi Genel Müdürü Paul Rowan şöyle diyor: "Toshiba'nın üçüncü kuşak BG SSD'leri hem mobil ve Nesnelerin İnterneti uygulamaları hem veri merkezi kullanımı için idealdir. Yeni BG3 serisi, şirket SATA'ları ve ana akım müşteri NVMe SSD'leri arasındaki güç ve fiyat mesafesini kapattığı ve aynı zamanda daha iyi güç tüketimli ve küçük ayakzili boot depolama sunduğu için, özellikle veri merkezlerinde BG3 kullanılması hem sermaye hem işletme masraflarını önemli ölçüde düşürebilir".

BG3'ün tek-paket tasarımı, Toshiba Flash bellek ile sıkıca entegre edilmiş ve Toshiba tarafından geliştirilmiş bir kontrolör ve bellek içerir ve performans, düşük güç ve güvenilirlik için optimal hale getirilmiştir. Çağdaş güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için, TCG^[10] Opal Version 2.01 içeren, kendi kendini şifreleyen sürücü seçenekleri (self-encrypting drive options, SED) de mevcuttur.

BG3 serisinin numuneleri müşterilere gönderilmektedir ve yeni seri 8-10 Ağustos tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde düzenlenecek olan 2017 Flash Bellek Zirvesi'nde 407 numaralı standta sergilenecektir.

Toshiba'nın sektörde öncü SSD'leri hakkında ayrıntılı bilgi için: <https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/storage-products.html>.

Notlar:

[1] NVMe, NVM Express, Inc'in markasıdır.

[2] Daha yüksek ardışık okuma/yazma transfer hızları.

[3] NVM Express ve NVM Express logosu kayıtlı markalardır.

[4] DRAM içeren M.2 2280 SSD'ler ve M.2 1620/2230 SSD'ler ile kıyaslandığında.

[5] 128GB ve 256GB BGA modelleri; 3 Ağustos 2017 tarihli Toshiba Memory Corporation anketi.

[6] PCI EXPRESS ve PCIe, PCI-SIG'in kayıtlı markalarıdır.

[7] Toshiba Memory Corporation test koşullarında BG3 serisi 512GB modeller kullanılarak 128KiB birimlerin ardışık okuma ve yazma hızları temelinde Toshiba Memory Corporation anketi. Okuma ve yazma hızı, ana aygıtta, okuma ve yazma koşullarına ve dosya boyuna bağlı olarak değişebilir. Toshiba Memory Corporation bir megabaytı (MB) 1.000.000 bayt ve bir kibibaytı (KiB) 2^{10} bayt veya 1.024 bayt olarak tanımlar. Burada belirtilen ardışık okuma ve yazma performansı referans verileridir ve veri sayfasında verilen BG3 ürün verilerinden farklı olabilir.

[8] Windows, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler'de ve/veya başka ülkelerde kayıtlı markasıdır.

[9] Kapasitenin tanımı: Toshiba Memory Corporation bir gigabaytı (GB) 1.000.000.000 bayt olarak tanımlar. Ancak bilgisayar işletim sistemleri, depolama kapasitesini belirtirken $1GB = 2^{30}$ bayt = 1,073,741,824 bayt tanımını kullanır ve dolayısıyla daha düşük depolama kapasitesi gösterir. Mevcut depolama kapasitesi (çeşitli medya dosyaları örnekleri dahil), dosya boyuna, formatlamaya, ayarlara, Microsoft İşletim Sistemi ve/veya önceden yüklenmiş yazılım uygulamaları gibi yazılım ve işletim sistemine, medya içeriğine bağlı olarak değişir. Gerçek formatlanmış kapasite farklı olabilir.

[10] Trusted Computing Group

* Burada sözü geçen şirket isimleri, ürün isimleri ve hizmet isimleri üretici şirketlerin markaları olabilir.

###

Toshiba Electronics Europe Hakkında

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#) 'ın Avrupa'daki elektronik parça şirketidir. TEE, otomotiv, multimedya, sanayi, telekom ve ağ uygulamaları için üst düzey bellekler, mikro kontrolörler, ASIC'ler ve ASSP'ler dahil, geniş bir IC ve ayrılc ürün yelpazesi sunmaktadır. Şirket ayrıca, geniş bir güç yarı iletken çözümleri ve HDD'ler, SSD'ler, SD Kartları ve USB bellekler gibi depolama ürünleri dizisi sunar.

TEE 1973 yılında Almanya'nın Neuss şehrinde kurulmuş olup, tasarım, imalat, pazarlama ve satış hizmetleri sunar. Genel merkezi şimdi Almanya'da Düsseldorf'tadır ve Fransa, İtalya, İspanya, İsveç ve İngiltere'de şubeleri vardır. TEE'nin Avrupa'da yaklaşık 300 çalışanı bulunmaktadır. Şirketin başkanı Bay Akira Morinaga'dır. Şirket hakkında ayrıntılı bilgi için TEE'nin internet sitesine bakabilirsiniz: www.toshiba.semicon-storage.com.

Yayın için iletişim bilgileri:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Faks: +49 (0) 211 5296 79197

İnternet: www.toshiba.semicon-storage.com

E-posta: spdinfo@tee.toshiba.de

Yayının içeriğiyle ilgili olarak iletişim için:

Barbara Mutz-Gutorski, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 5296 576

E-posta: BMutzGutorski@tee.toshiba.de

Yayınlayan:

Birgit Schoeniger / Georgia Sorrel, Publitek,

Tel: +44 (0) 20 8429 6554 / +44 (0) 20 8429 6549

İnternet: www.publitek.com

E-posta: birgit.schoeniger@publitek.com veya georgia.sorrel@publitek.com

Ağustos 2017

Sayı TBS012/A